

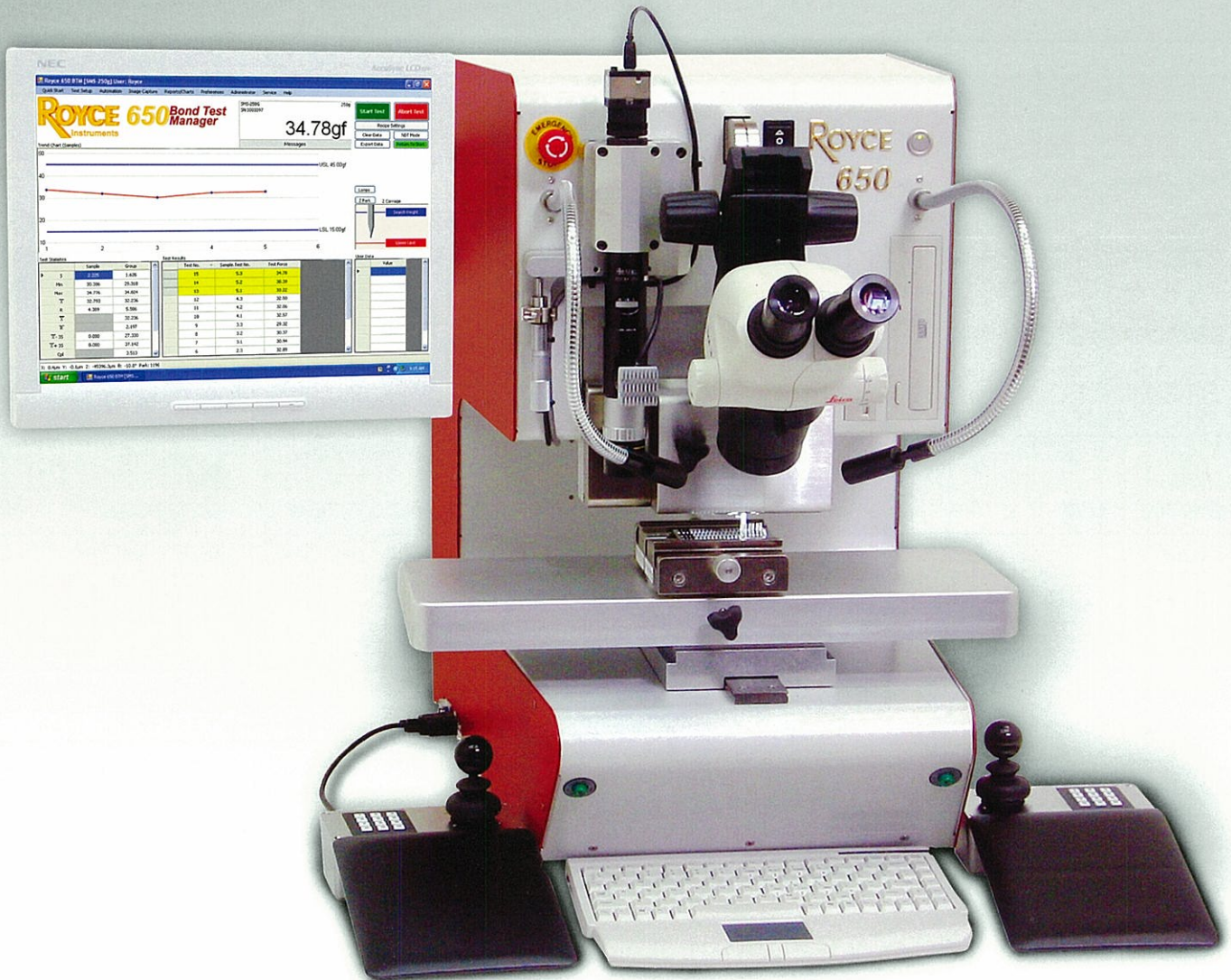


HUGLE®
Clean & Quality

洗練された多機能性が
完璧な各種ボンドテストを実現。

ユニバーサルボンドテスター

System 650



Feature [システムの特長]

- 各国語対応
- コンパクトタイプ、Windows XP PC内蔵
- テストモジュールレンジの切り替え可能
- ダイシエATEST最大200kgまで対応
- 超微細ピッチ対応、拡大倍率128倍、高倍率イメージキャプチャー
- ワーキングステージ(305mm×105mm)、300mmウェハー、リードフレーム、基板に対応
- 豊富なデータ分析(Oracle SQL compatible)



テストモジュール	プライマリーレンジ	サブレンジ			
ワイヤブルモジュール	100gf 1kgf 10kgf	10gf 100gf 1kgf	20gf 200gf 2kgf	50gf 500gf 5kgf	100gf 1kgf 10kgf
ダイシエアモジュール	20kgf 200kgf	2kgf 20kgf	5kgf 50kgf	10kgf 100kgf	20kgf 200kgf
ワイヤードシエアモジュール	250gf 1kgf 5kgf	25gf 100gf 500gf	50gf 200gf 1kgf	100gf 500gf 2kgf	250gf 1kgf 5kgf
CBP/ツイザーブルモジュール	100gf 1kgf 10kgf	10gf 100gf 1kgf	20gf 200gf 2kgf	50gf 500gf 5kgf	100gf 1kgf 10kgf
モジュール精度	0.15%				
モジュール分解能	1 : 10,000				

■ システム仕様

内蔵PC	高機能PC標準装備、DVD-CD R/Wドライブ内蔵 USB、ネットワークポート
サーボ駆動 X/Yステージ	スタンダード、305mm×155mm
X/Y分解能	1ミクロン
Z分解能	0.1ミクロン
位置戻り精度	25ミクロン ± 1ミクロン
ループハイト測定	可能
フォースプロファイル	可能
世界規格対応	Mil Std 883、Mil Std750、ASTM、JESD22-B117、 JESD22-B116、CEマーキング、RoHS対応

■ 装置本体寸法 及び ユーティリティー

高さ	560mm、25インチ
幅	432mm、17インチ
奥行	585mm、23インチ
重量	55kg
電源	110~220VAC 50/60Hz
ドライエア	60~80psi
真空	500mm Hg

※ユニバーサルボンドテスター System650の詳細、デモのご利用は下記本社・営業所へお問い合わせ下さい。

h ヒューグルエレクトロニクス株式会社

本社：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-5-8 TEL (03) 3263-6685 FAX (03) 3263-6686
 名古屋営業所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7 TEL (052) 220-3861 FAX (052) 220-3862
 関西営業所：〒567-0888 大阪府茨木市駅前1-2-10 TEL (072) 620-8500 FAX (072) 620-8504
 九州営業所：〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2158-26 TEL (096) 232-6131 FAX (096) 232-6133
 板橋工場：〒174-0046 東京都板橋区蓮根3-14-13 TEL (03) 3558-7911 FAX (03) 3965-7540
 鳩ヶ谷工場：〒334-0013 埼玉県鳩ヶ谷市南2-20-3 TEL (048) 284-0804 FAX (048) 286-4490
 Korea Hugle Electronics Inc.: Hugle Bldg, 86-14 Garak-Dong, TEL 82-2-431-7477 FAX 82-2-449-6295
 Songpa-ku, Seoul, Korea

URL <http://www.hugle.co.jp> E-mail assy@hugle.co.jp